KTQ-GX Challenge 2050

みんなで考えよう、AI・環境・エネルギーを支える半導体について

北九州半導体ネットワーク

先端半導体 を術セミブ

12 ₁ **4** ₁ 15:00~18:30

定員:100名

会場:北九州学術研究都市

「セミナー」学術情報センター 遠隔講義室1

「交流会」 会議場 イベントホール



AI、クラウド、光通信や5G/6G、EV·SDVといった先端産業分野の発展とともに地球環境への配慮が不可 欠となる中で、先端産業を支える半導体分野においても、製品や製造プロセスにおけるGX対応が、今後に むけた重要な要素となっています。

新たな時代に向けた環境とエネルギーの共生を目指した取り組みを進めている北九州市の「知の拠点」北 九州学術研究都市から、企業や大学等の皆様に、発展する先端産業とそれを支える半導体技術の関係性や 進化する半導体技術の最新動向を発信いたします。

AI半導体とチップレット技術

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 AIチップデザインオープンイノベーションラボラトリ 招聘研究員



Ζ 通信と情報処理に変革をもたらすⅠDWN構想と それを支える光電融合デバイス技術

NTT株式会社

先端集積デバイス研究所 所長 竹ノ内 弘和 氏

セミナー後は、交流会(参加費無料)を開催!

お問合せ

公益財団法人北九州産業学術推進機構[FAIS] 住所:福岡県北九州市若松区ひびきの2-1

半導体産業支援センター内 電話:093-695-3007

北九州半導体ネットワーク事務局 メール: ksnet@ksrp.or.jp

主催:北九州市、公益財団法人北九州産業学術推進機構

後援:九州経済産業局、一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会

福岡県(予定)、公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団



内山 邦男 氏

スケザュール

- 1 15:00~15:10 開会挨拶と事務局説明
- 2 15:10~16:10 講演1「AI半導体とチップレット技術」

2010年代初頭に始まったディープラーニング技術の急速な発展と、近年における生成AIの劇的な進歩は、計算需要を飛躍的に高め、それを支えるAI半導体の開発を加速させている。本講演では、GPUや専用AIアクセラレータの進化を概観するとともに、性能・電力効率・設計柔軟性を高める手段として注目されるチップレット技術の最新動向と応用可能性について議論する。

- 3 16:10~16:15 休憩
- 4 16:15~17:15 講演2「通信と情報処理に変革をもたらすIOWN構想と それを支える光電融合デバイス技術」

光インターコネクションの適用領域が長距離光伝送からデータセンタ内ネットワークなどの短距離通信まで拡大してきており、今後はLSIのパッケージ間・パッケージ内にも光技術の活用が進むと考えられる。本講演では、そのような世界を見据え、弊社が進めている光電融合デバイス技術の取り組みや、光電融合デバイスを活かす新しいコンピュータアークテクチャの取り組みについて紹介する。

5 17:30~18:30 交流会(参加費無料)

講師プロフィール



国立研究開発法人産業技術総合研究所 AIチップデザイン オープンイノベーションラボラトリ 招聘研究員 内山 邦男 氏

東工大大学院情報科学科修士卒、博士(工学)

日立製作所中央研究所に入社、CAD、メインフレーム、マイクロプロセッサ、SoCの研究開発に従事。

日立製作所の技師長、理事、技術顧問を経て、現在、産業総合技 術研究所の招聘研究員としてAIチップ設計拠点の拠点長を務める。 市村賞、科学技術長官賞、紫綬褒章などを受章。

IEEE/IEICEフェロー。



NTT株式会社 先端集積デパイス研究所 所長 竹ノ内 弘和 氏

1994年東京大学大学院 理学系研究科 修了同年、日本電信電話株式会社 入社

2011年 NTTフォトニクス研究所 革新光デバイス研究グループグループリーダー 2018年NTT先端技術総合研究所 企画部 部長

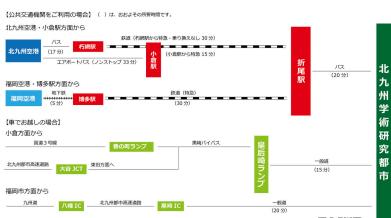
2022年NTT先端集積デバイス研究所 所長 (現職)

光信号処理方式・デバイスの研究開発・マネジメントに従事。 現在は、NTTグループにおける光・電子デバイス研究を統括、 博士(工学)

学術情報センター 〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの1-3

この看板が目印です





混雑緩和のため、公共交通機関のご利用にご協力をお願いします。 車でお越しの際は、イベント駐車場をご利用ください(無料)

